

2026年5月8日

各位

会社名 京セラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 執行役員社長  
最高経営責任者  
作島 史朗  
(コード6971 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 執行役員常務  
最高財務責任者  
経営企画室担当 兼 コーポレート担当  
千田 浩章  
TEL. 075-604-3500

## (訂正)「2026年3月期 決算説明会資料」

2026年4月30日に発表した適時開示資料「2026年3月期 決算説明会資料」につきまして、訂正すべき箇所がございましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

### 記

#### 1. 訂正の理由

記載の内容に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正します。

#### 2. 訂正の内容

(1) 2026年3月期 決算説明会資料

(訂正前)

P20 : 2027.3期 業績予想(1)

2027.3期 EPS(円) 100.54

(訂正後)

P20 : 2027.3期 業績予想(1)

2027.3期 EPS(円) 102.73

以上

# 2026年3月期 決算説明会

2026年4月30日

代表取締役社長 兼 執行役員社長  
最高経営責任者  
作島 史朗

1. はじめに
2. 2026.3期 決算概要
3. 2027.3期 業績予想
4. 2028.3期 経営計画
5. 【ご参考】 補足資料

# 1. はじめに

---

## 京セラの新たな価値創造ストーリーを描き、企業価値向上の実現を果たす

- 当社は、創業者の掲げた企業哲学と経営理念を普遍的な経営の基軸として大切に受け継いできました。企業に求められる価値観が大きく変容する現代において、私自身もこれらを経営の根幹に据え続け、高い倫理観と強い使命感を持って経営を推進して参ります。
- 同時に、激変する世界情勢や事業環境に適合し、直面する経営諸課題を克服するため、当社独自のアメーバ経営を進化させることによって、迅速かつ柔軟な事業運営を推進することこそが、本年4月より最高経営責任者の任にあたる私の最重要の使命と捉えています。
- 事業面では、事業ポートフォリオマネジメントの積極的な強化を通じて価値あるイノベーションを創出し、産業界での存在価値を高めます。
- 人財面では、創業の精神に立ち返り、全員参加経営の実践を通じて、社員ひとりひとりの潜在能力が最大限に発揮されるように、部門横断的な組織活性化を推進します。
- 資本・財務面では、株式市場との対話を重視し、成長投資と株主還元の適正な按分を維持するとともに、全社視点で経営資源を適切に配分し、中長期的な事業成長と資本効率向上の両立を図ります。
- これらの取り組みを通じて、京セラの新たな価値創造ストーリーを描き、企業価値向上の実現を果たすことによって、世界から尊敬される「ザ・カンパニー」を目指して参ります。

## 経営企画室の設立

- 「注力事業領域」「投資判断」「資本配分」の3つをより全社視点で捉え、各事業/各アミーバが持つ潜在能力を最大限に発揮できるフィールド/仕組み構築を主導

2026年  
3月期

### 経営改革プロジェクト

事業ポートフォリオ再編や資本政策等  
ハイレベルな全社方針を策定

▼ 継続・深化

2027年  
3月期～

### 経営企画室

ROICによるポートフォリオ管理や  
そのための投資管理等、経営の仕組みを高度化

## 経営企画室の役割と主な機能

- M&Aや研究開発、生産設備投資、IT/DX投資等を連動させ、中期的な経営目標の実現に向けた成長戦略策定と進捗モニタリングを担う

### ＜主な機能＞



## 2. 2026.3期 決算概要

---

注：2026.3期 期首より、2025.3期まで「コアコンポーネント」セグメントの「その他」に含めていた宝飾・応用商品事業を「ソリューション」セグメントの「その他」に含めることとし、「ソリューション」セグメントの「その他」に含めていたディスプレイ事業を「コアコンポーネント」セグメントの「産業・車載用部品」に含めて業績管理することとしました。また、2026年1月1日より、「コアコンポーネント」セグメントの「産業・車載用部品」に含めていた事業の一部を同セグメントの「半導体関連部品」に含めて業績管理することとしました。これらの変更に伴い、2025.3期の業績は、この管理区分にて表示しています。

# 2026.3期 実績(1)



売上高：サザンカールソン社\*譲渡に伴う減収はあったものの、半導体関連部品事業を中心にコアコンポーネントが増収

利益：2025.3期及び2026.3期に計上した一時損益の影響に加え、増収効果や構造改革の進展等により大幅増益

\*建設・産業向け資材・工具の米国流通事業を展開する米国子会社である Kyocera Industrial Tools, Inc. (その100%子会社である SouthernCarlson, Inc.並びにその子会社を含む)

(単位：百万円 / ( ) 内の数字は売上高比率)

	2025.3期	2026.3期	増減	
			金額	率
売上高	2,014,454	<b>2,070,203</b>	55,749	2.8%
営業利益	27,299 (1.4%)	<b>118,138</b> (5.7%)	※1 90,839	332.8%
税引前利益	63,631 (3.2%)	<b>168,994</b> (8.2%)	※1 105,363	165.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益	24,097 (1.2%)	<b>140,969</b> (6.8%)	※1 116,872	485.0%
EPS(円)	17.11	<b>102.70</b>	為替変動による影響額 (前期比) 売上高 : 約 +90億円 税引前利益 : 約 +65億円	
平均為替レート				
	米ドル	153円	<b>151円</b>	
	ユーロ	164円	<b>175円</b>	

※1 各段階利益の増減金額に含まれる一時損益等については次頁参照

※2 営業利益と税引前利益 増減金額の差:前期における急速な円高進行に伴い計上した為替差損の影響 +約140億円

### ・ 営業利益及び税引前利益に含まれる一時損益

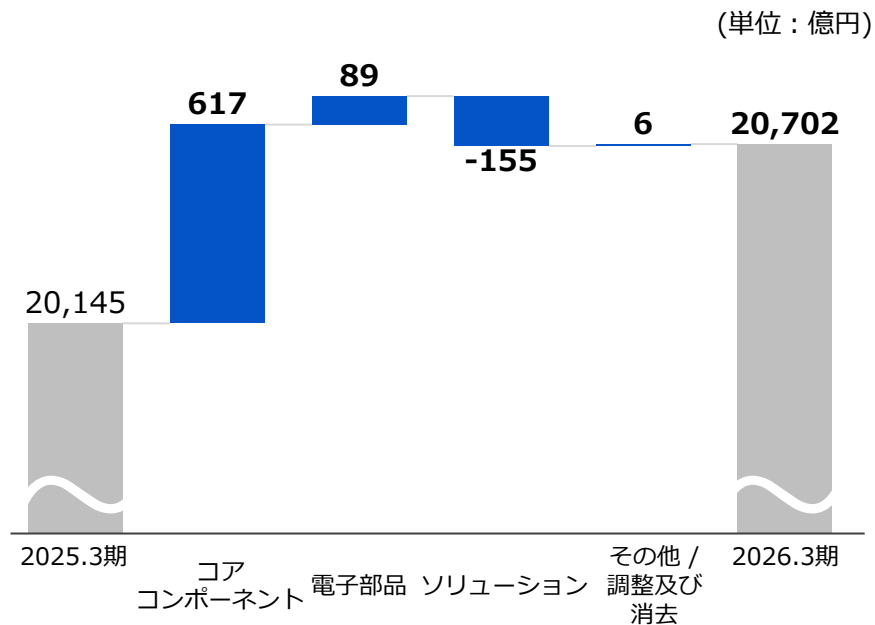
	2025.3期	2026.3期	増減金額 (前期比における影響額)
①半導体部品有機材料事業 有形固定資産の減損損失等	約△430億円	-	約+430億円
②半導体部品有機材料事業 未稼働資産の評価減	-	約△50億円	約△50億円
③シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡に伴う損失	-	約△15億円	約△15億円
④車載システム事業（旧ディスプレイ事業）に係る有形固定資産等の減損損失		約△50億円	約△50億円
⑤サザンカールソン社の譲渡に伴う利益	-	約+170億円	約+170億円
<b>営業利益及び税引前利益に含まれる一時損益 合計</b>	<b>約△430億円</b>	<b>約+55億円</b>	<b>約+485億円</b>

### ・ 当期利益に含まれる一時損益

	2025.3期	2026.3期	増減金額 (前期比における影響額)
⑥上表①～⑤の一時損益に関する税効果考慮後の金額	約△300億円	約+80億円	約+380億円
⑦海外子会社における繰延税金資産の取り崩し等	約△180億円	-	約+180億円
⑧KDDI株式売却に伴う税金費用の調整	-	約+120億円	約+120億円
<b>親会社の所有者に帰属する当期利益に含まれる一時損益 合計</b>	<b>約△480億円</b>	<b>約+200億円</b>	<b>約+680億円</b>

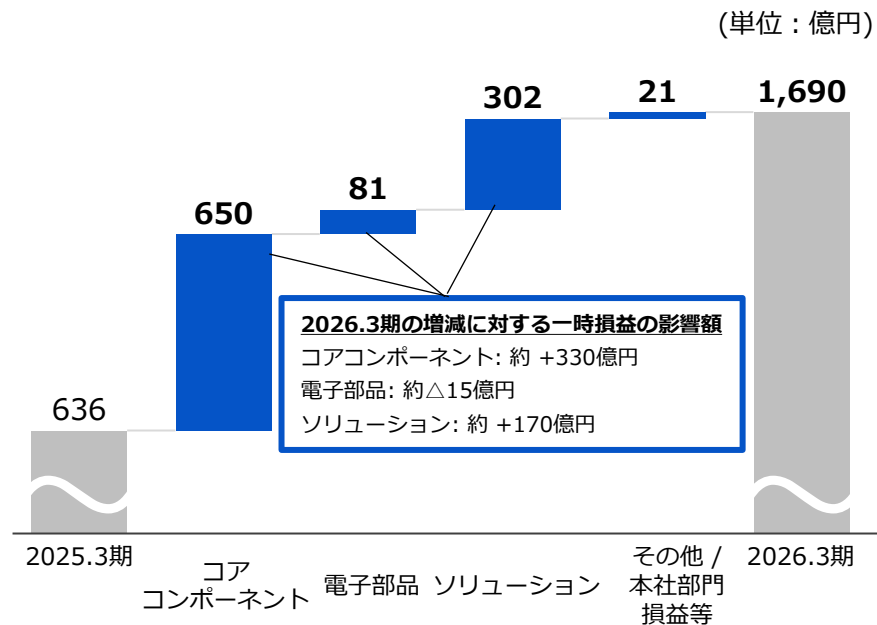
## 売上高

- 半導体部品セラミック材料事業の販売増を主因に増収



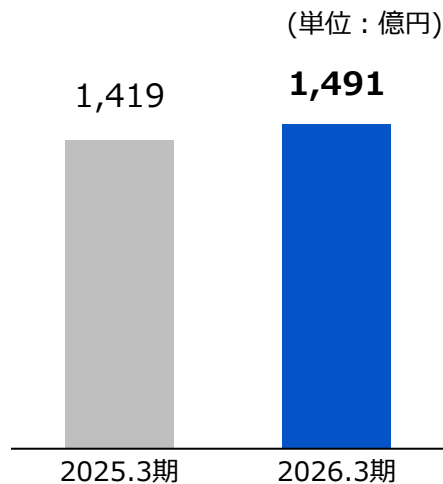
## 税引前利益

- サザンカールソン社の譲渡に伴う一時利益の計上、及び2025.3期は半導体部品有機材料事業において減損損失を計上したこともあり大幅増益



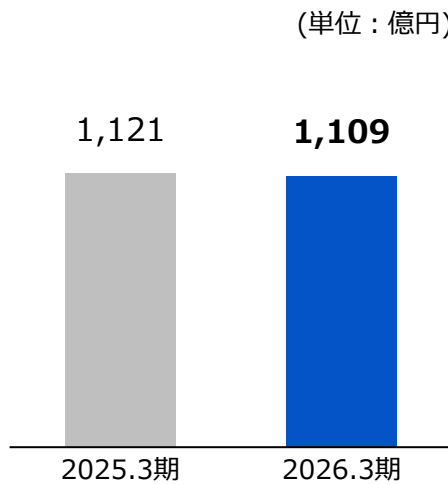
## 設備投資額

主に国内工場において将来の生産規模拡大や自動化に向けて過年度より着手していた新棟建設が完工したことに伴う増加



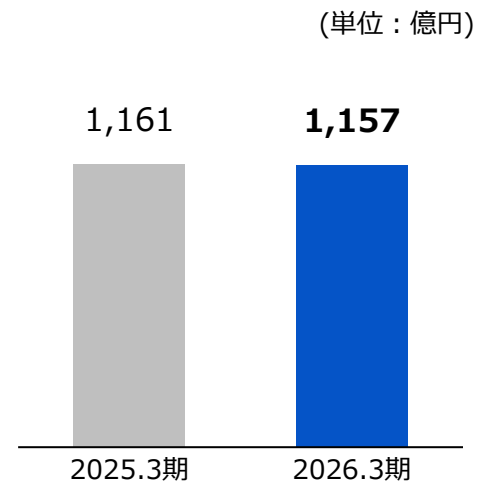
## 有形固定資産 減価償却費

国内工場における新棟完工等に伴う増加があったものの、主に2025.3期における半導体部品有機材料事業の減損損失の影響により減少



## 研究開発費

研究開発テーマの見直しにより微減



# 2026.3期 セグメント別売上高



(単位：百万円)

	2025.3期		2026.3期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	591,720	29.4%	<b>653,429</b>	<b>31.6%</b>	61,709	10.4%
産業・車載用部品	241,871	12.0%	250,069	12.1%	8,198	3.4%
半導体関連部品	327,049	16.3%	379,432	18.3%	52,383	16.0%
その他	22,800	1.1%	23,928	1.2%	1,128	4.9%
<b>電子部品</b>	354,646	17.6%	<b>363,486</b>	<b>17.5%</b>	8,840	2.5%
<b>ソリューション</b>	1,086,367	53.9%	<b>1,070,919</b>	<b>51.7%</b>	-15,448	-1.4%
機械工具	305,876	15.2%	285,936	13.8%	-19,940	-6.5%
ドキュメントソリューション	479,964	23.8%	478,479	23.1%	-1,485	-0.3%
コミュニケーション	225,497	11.2%	219,158	10.6%	-6,339	-2.8%
その他	75,030	3.7%	87,346	4.2%	12,316	16.4%
その他の事業	17,114	0.9%	14,196	0.7%	-2,918	-17.1%
調整及び消去	-35,393	-1.8%	-31,827	-1.5%	3,566	—
<b>売上高</b>	2,014,454	100.0%	<b>2,070,203</b>	<b>100.0%</b>	55,749	2.8%

# 2026.3期 セグメント別利益

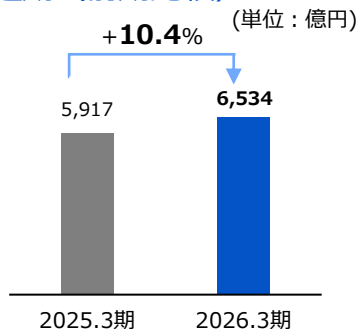


(単位：百万円)

	2025.3期		2026.3期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	-1,889	—	<b>63,082</b>	<b>9.7%</b>	64,971	—
産業・車載用部品	23,295	9.6%	18,730	7.5%	-4,565	-19.6%
半導体関連部品	-26,447	—	46,933	12.4%	73,380	—
その他	1,263	5.5%	-2,581	—	-3,844	—
<b>電子部品</b>	-818	—	<b>7,316</b>	<b>2.0%</b>	8,134	—
<b>ソリューション</b>	73,696	6.8%	<b>103,943</b>	<b>9.7%</b>	30,247	41.0%
機械工具	15,707	5.1%	35,196	12.3%	19,489	124.1%
ドキュメントソリューション	49,038	10.2%	45,115	9.4%	-3,923	-8.0%
コミュニケーション	9,347	4.1%	12,116	5.5%	2,769	29.6%
その他	-396	—	11,516	13.2%	11,912	—
その他の事業	-46,990	—	-41,168	—	5,822	—
<b>事業利益 計</b>	23,999	1.2%	<b>133,173</b>	<b>6.4%</b>	109,174	454.9%
本社部門損益等	39,632	—	35,821	—	-3,811	-9.6%
<b>税引前利益</b>	63,631	3.2%	<b>168,994</b>	<b>8.2%</b>	105,363	165.6%

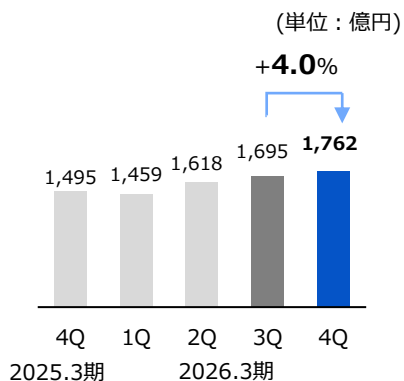
## 売上高

### 通期（前期比較）



情報通信関連市場向けセラミックパッケージ、及びデータセンター向け有機パッケージ等、半導体関連部品事業の販売増を主因に増加

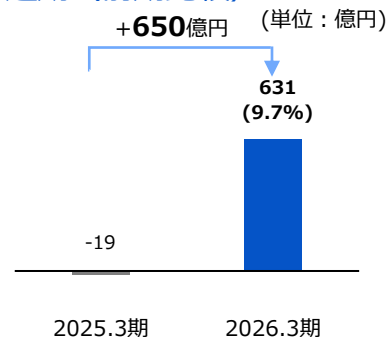
### 第4四半期（直前四半期比較）



半導体製造装置用部品の販売増等を主因に増加

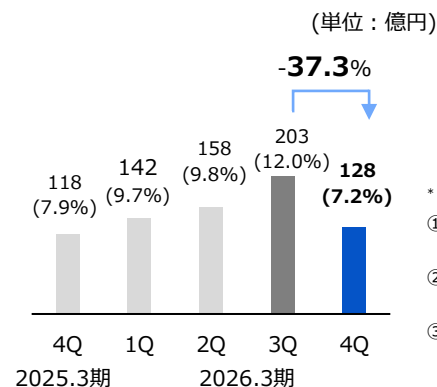
## 事業利益（利益率）

### 通期（前期比較）



増収及び構造改革効果に加え、一時損失\*の減少により大幅に増加

### 第4四半期（直前四半期比較）



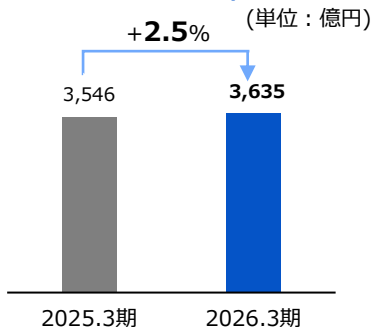
増収効果はあったものの、一時損失\*の計上及び原材料価格の高騰等によりセグメント全体で減益

\* 一時損失の内訳

- ①2025.3期 3Q 半導体部品有機材料事業  
有形固定資産の減損損失等：約△430億円
- ②2026.3期 3Q 半導体部品有機材料事業  
未稼働資産の評価減：約△50億円
- ③2026.3期 4Q 車載システム事業  
旧ディスプレイ事業の減損等：約△50億円

## 売上高

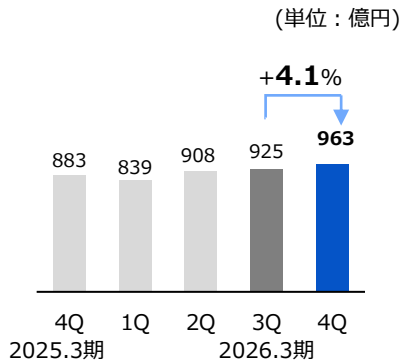
### 通期（前期比較）



KAVXグループ\*における車載市場・情報通信関連市場向けコンデンサ等の販売増が、米ドルに対する円高進行による減収を上回ったことにより増加

\* Kyocera AVX Components Corporation グループ

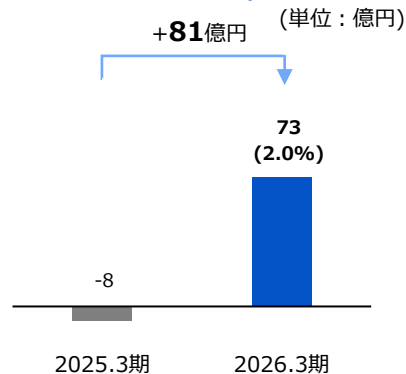
### 第4四半期（直前四半期比較）



車載市場を中心にセンサー・制御部品やコンデンサ等の販売増を主因に増加

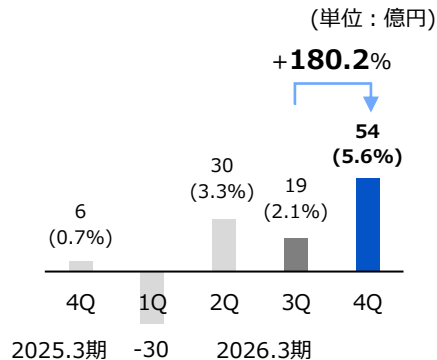
## 事業利益（利益率）

### 通期（前期比較）



シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡に伴う一時損失 約15億円の影響があった一方、KAVXグループにおける増収や構造改革の効果を主因に増加

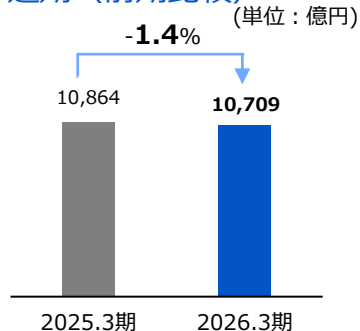
### 第4四半期（直前四半期比較）



増収効果及び原価低減等により増加

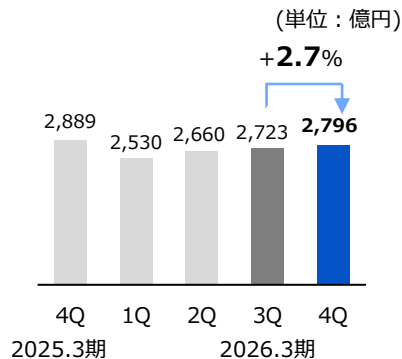
## 売上高

### 通期（前期比較）



サザンカーンソンの譲渡が完了したことに伴う減収 約270億円を主因に減少

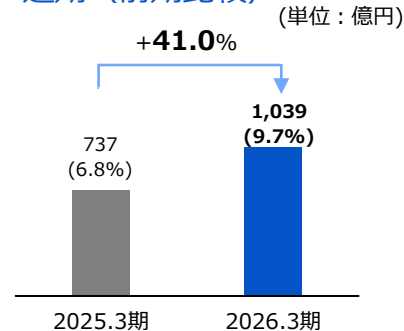
### 第4四半期（直前四半期比較）



ドキュメントソリューション事業及びコミュニケーション事業における販売増を主因に増加

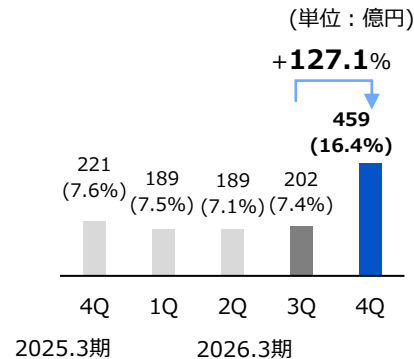
## 事業利益（利益率）

### 通期（前期比較）



サザンカーンソン社譲渡に伴う一時利益 約170億円の計上、及び各事業での収益改善等により増加

### 第4四半期（直前四半期比較）



サザンカーンソン社譲渡に伴う一時利益 約170億円の計上に加え、増収効果により増加

✓ 2026.3期においては、未稼働資産の評価減 約50億円を計上したものの、コスト構造の転換に係る施策を推進し、同評価減を除いた場合には**通期黒字化**を達成

半導体部品  
有機材料事業  
(コアコンポーネント)

低採算製品の縮小

生産人員の最適化

減価償却費の低減

2025.3期 生産設備の減損に伴い、2025.3期と比較して

約70億円減少

+

高付加価値製品の増加

ネットワークASIC向け  
高多層基板の受注拡大

一時損失を除いた場合  
2025.3期からの  
事業利益 増益額

約 **185**億円

✓ 2026.3期においては、京セラ電子部品事業との協業により生産技術・設備効率を強化し、**通期黒字化**を達成

KAVXグループ  
(電子部品)

セラミックコンデンサ

技術・設備力強化による  
歩留まり改善

+

タンタルコンデンサ

高付加価値製品の拡大  
生産性の改善

2025.3期からの  
事業利益 増益額

約 **126**億円

# 事業譲渡及び組織再編

## 事業譲渡

<p><b>シリコンダイオード・ パワー半導体事業</b> (電子部品)</p>	<p>✓ 2026.3期(2026年1月)において、当社が設立した新会社への対象事業の吸収分割、新電元工業株式会社への新会社株式譲渡が完了</p>	<p><b>各事業の ベストオーナーへの 譲渡により 当社のポートフォリオ 改革が進展</b></p>
<p><b>空圧・電動工具事業</b> (ソリューション)</p>	<p>✓ 2026.3期(2026年1月)において、建設・産業向け資材・工具の米国ディストリビューター(サザンカールソン社)の米国 TL Sapphire Holdings, Inc.*への譲渡が完了</p> <p>* Truelink Capital Management, LLCの関連会社</p>	
<p><b>ケミカル事業</b> (コアコンポーネント)</p>	<p>✓ 対象事業を当社が設立する新会社に対して吸収分割させ、新会社を住友ベークライト株式会社への譲渡を決議</p> <p>✓ 2027.3期(2026年10月末)に譲渡実行予定</p>	

## 組織再編

<p><b>半導体製造装置用部品 関連事業の統合</b> (コアコンポーネント)</p>	<p>✓ 2026.3期(2026年1月)に自動車部品事業にて製造していた一部のSPE部品をファインセラミック部品事業へ集約</p>	<p>今後の取組み <b>技術面でのシナジー創出による 高付加価値新製品の拡大</b></p>
<p><b>車載カメラ事業と ディスプレイ事業の統合</b> (コアコンポーネント)</p>	<p>✓ 車載カメラ事業とディスプレイ事業(HUD/次世代車載ミラー用)を統合</p> <p>✓ 2026.3期において、市場競争の激化等による業績不振に伴い、旧ディスプレイ事業の有形固定資産等について減損損失 約50億円を計上</p>	<p>今後の取組み <b>新製品開発による売上向上 及び 原価率の低減</b></p>

## 配当

### 配当方針

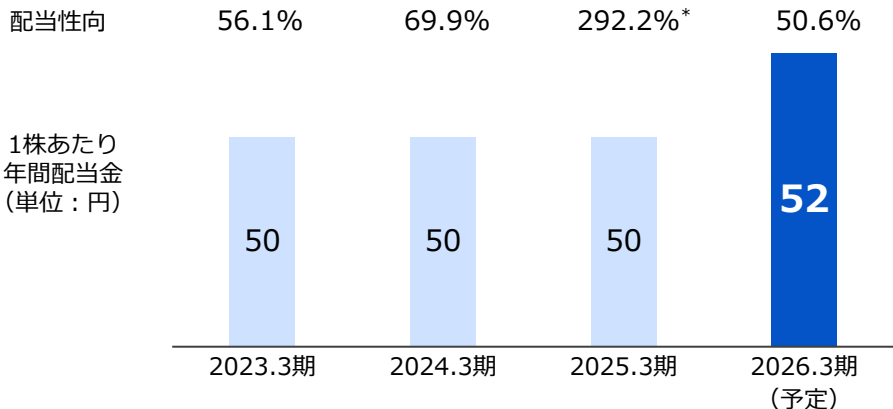
連結業績の「親会社の所有者に帰属する当期利益」の範囲を目安とすることを原則とし、連結配当性向を50%程度の水準で維持

### 年間配当金

1株当たり **52円**  
配当性向: 50.6%  
(中間配当25円+期末配当27円)

前回予想(2025年10月公表)と比較して

1株当たり **2円** 増配



※全ての期において、2024年1月1日に実施した株式分割後の基準で算出しています。

\*当期利益に約480億円の一時損失含む

## 自己株式の取得

### 2026.3期 実績

- 2025年5月に2,000億円の自己株式取得について決議
- 2026年3月に決議内容に基づく自己株式の取得が完了

#### 取得実績

約 **91** 百万株 / 約 **2,000** 億円

## 政策保有株式の縮減

公表済

### 2026.3期 実績

- 2025年6月 KDDI(株)の自社株TOBにより同社株式を売却

#### 売却実績

約 **108** 百万株 / 約 **2,500** 億円

#### 政策保有株式の純資産比率 (KDDI株以外も含む)

2025.3期末 **51.6%** → 2026.3期末 **48.3%** → 2031.3期末 目標 **20.0%** 未滿

2027.3期以降も縮減を継続

## 3. 2027.3期 業績予想

---

注：2027.3期より、「その他の事業」に含めていた要素技術研究等を「本社部門損益等」に含めて業績管理することとしました。これに伴い、同条件での比較を行うため、P.23～P.24に記載の2026年3月期の業績についても、同様の管理区分にて表示しています。

# 2027.3期 業績予想(1)



(単位：百万円)

	2026.3期	2027.3期	増減金額	
			金額	率
売上高	2,070,203	<b>1,940,000</b>	-130,203	-6.3%
営業利益	118,138 (5.7%)	<b>130,000</b> (6.7%)	11,862	10.0%
税引前利益	168,994 (8.2%)	<b>170,000</b> (8.8%)	1,006	0.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益	140,969 (6.8%)	<b>141,000</b> (7.3%)	31	0.0%
EPS(円)	102.70	<b>102.73</b> *		
平均為替 レート	米ドル	151円	<b>150円</b>	
	ユーロ	175円	<b>175円</b>	
設備投資額	149,099 (7.2%)	<b>225,000</b> (11.6%)	75,901	50.9%
有形固定資産 減価償却費	110,924 (5.4%)	<b>120,000</b> (6.2%)	9,076	8.2%
研究開発費	115,701 (5.6%)	<b>120,000</b> (6.2%)	4,299	3.7%

\* 2027年3月期予想のEPSは、2026年3月期の期中平均株式数を用いて算出。

( ) 内の数字は売上高比率

## 2026.3期下期の状況を踏まえ、原材料価格上昇等の影響を2027.3期 業績予想に反映

### 2027.3期の市場環境

- ✓ マクロ経済 (国内経済/世界経済) : 原材料価格の高騰や地政学リスク等により不透明な状況が継続する懸念
- ✓ 当社の主要市場 : 半導体関連市場においては、AI関連投資の加速が見込まれる一方で、自動車関連市場は減速

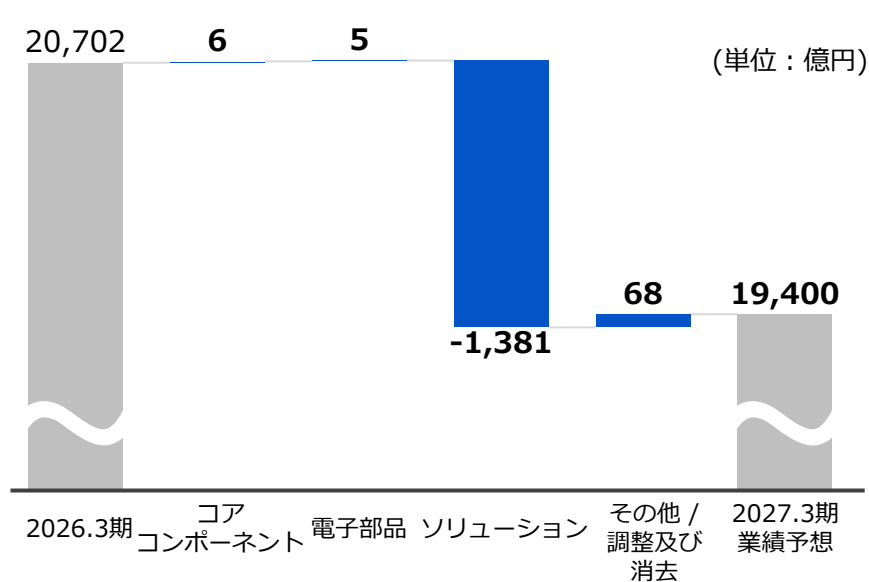
### 2027.3期 業績予想の前提

- ✓ 供給逼迫や価格上昇が生じている下表の原材料については、2026.3期 下期における市場価格を前提に立案
- ✓ 価格上昇に関する対応策としては、当社製品への価格転嫁、並びに代替材料/代替調達先への切り替えを推進
- ✓ 中東情勢悪化に起因する石油由来製品の入手困難/価格上昇については、現時点で影響額の算出が困難なため、業績予想には未反映。

	主に影響を受ける事業
①レアメタル/レアアースの供給逼迫及び価格上昇	半導体関連部品/機械工具
②金の価格上昇	半導体関連部品/電子部品 他
③半導体メモリの供給逼迫及び価格上昇 他	ドキュメントソリューション/通信機器 他

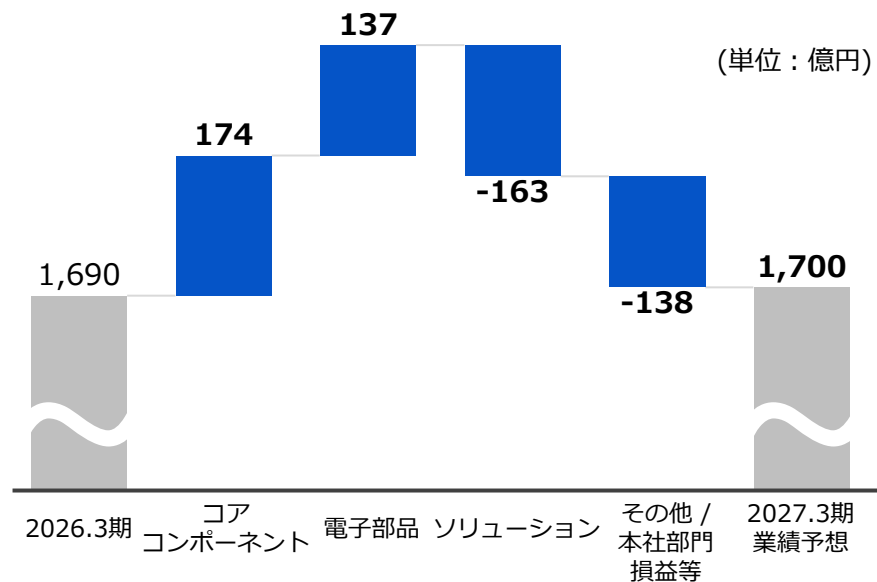
## 売上高

- サザンカールソン社譲渡に伴う売上減を主因にソリューションが減収



## 税引前利益

- コアコンポーネント/電子部品：構造改革効果による増益
- ソリューション：2026.3期においてはサザンカールソン社譲渡による一時利益 約170億円を計上
- その他：配当収入の減少及び生産技術開発等の増加



# 2027.3期 セグメント別売上高予想



(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	653,429	31.6%	<b>654,000</b>	<b>33.7%</b>	571	0.1%
産業・車載用部品	250,069	12.1%	246,000	12.7%	-4,069	-1.6%
半導体関連部品	379,432	18.3%	380,000	19.6%	568	0.1%
その他	23,928	1.2%	28,000	1.4%	4,072	17.0%
<b>電子部品</b>	363,486	17.6%	<b>364,000</b>	<b>18.7%</b>	514	0.1%
<b>ソリューション</b>	1,070,919	51.7%	<b>932,800</b>	<b>48.1%</b>	-138,119	-12.9%
機械工具	285,936	13.8%	170,000	8.8%	-115,936	-40.5%
ドキュメントソリューション	478,479	23.1%	480,000	24.7%	1,521	0.3%
コミュニケーション	219,158	10.6%	188,000	9.7%	-31,158	-14.2%
その他	87,346	4.2%	94,800	4.9%	7,454	8.5%
その他の事業	14,196	0.7%	15,000	0.8%	804	5.7%
調整及び消去	-31,827	-1.5%	-25,800	-1.3%	6,027	—
<b>売上高</b>	2,070,203	100.0%	<b>1,940,000</b>	<b>100.0%</b>	-130,203	-6.3%

# 2027.3期 セグメント別利益予想

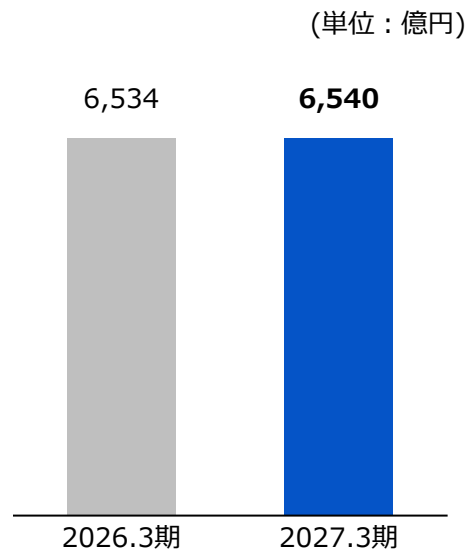


(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	63,082	9.7%	<b>80,500</b>	<b>12.3%</b>	17,418	27.6%
産業・車載用部品	18,730	7.5%	28,000	11.4%	9,270	49.5%
半導体関連部品	46,933	12.4%	53,000	13.9%	6,067	12.9%
その他	-2,581	—	-500	—	2,081	—
<b>電子部品</b>	7,316	2.0%	<b>21,000</b>	<b>5.8%</b>	13,684	187.0%
<b>ソリューション</b>	103,943	9.7%	<b>87,600</b>	<b>9.4%</b>	-16,343	-15.7%
機械工具	35,196	12.3%	16,000	9.4%	-19,196	-54.5%
ドキュメントソリューション	45,115	9.4%	45,000	9.4%	-115	-0.3%
コミュニケーション	12,116	5.5%	13,200	7.0%	1,084	8.9%
その他	11,516	13.2%	13,400	14.1%	1,884	16.4%
その他の事業	-21,742	—	-26,000	—	-4,258	—
<b>事業利益 計</b>	152,599	7.4%	<b>163,100</b>	<b>8.4%</b>	10,501	6.9%
本社部門損益等	16,395	—	6,900	—	-9,495	-57.9%
<b>税引前利益</b>	168,994	8.2%	<b>170,000</b>	<b>8.8%</b>	1,006	0.6%

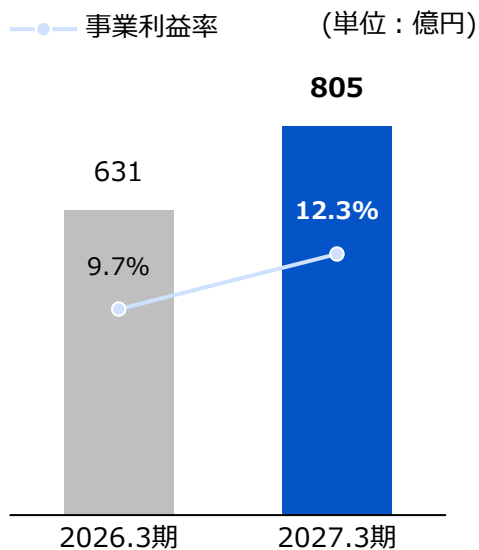
## 売上高

半導体セラミック材料事業におけるケミカル事業売却の影響 約△110億円を他の事業の拡大で相殺



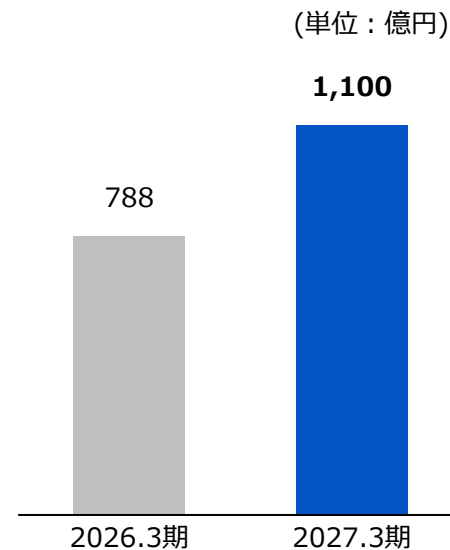
## 事業利益

高付加価値製品の拡大及び2026.3期には一時損失を計上した影響により増加



## 設備投資額

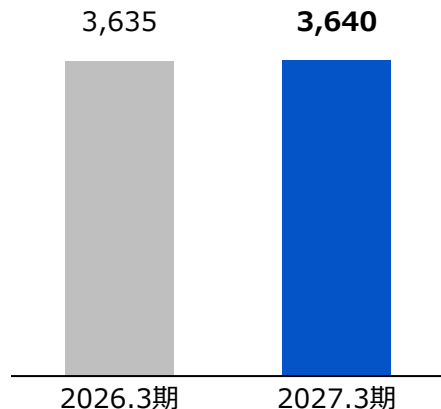
2027.3期においては長崎諫早工場の完工を予定していることに伴い増加



## 売上高

シリコンダイオード・パワー半導体事業を譲渡したことによる減収影響を、半導体・AIサーバーを中心とした成長市場向けMLCC、タンタルコンデンサの販売増によりカバーし、横ばい

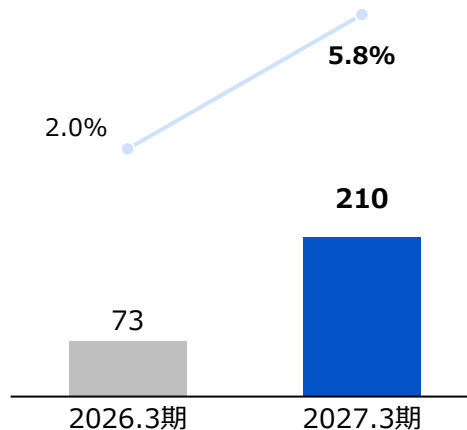
(単位：億円)



## 事業利益

MLCC、タンタルコンデンサ、コネクタにおける生産性改善による収益性向上、及び成長市場での新製品投入により増加

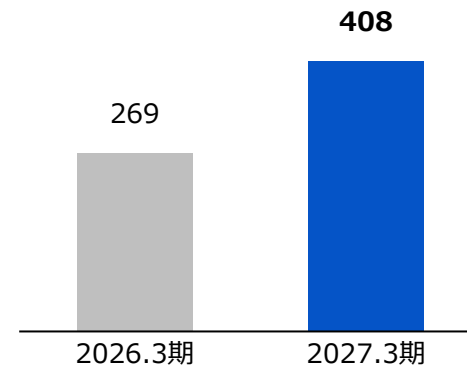
事業利益率 (単位：億円)



## 設備投資額

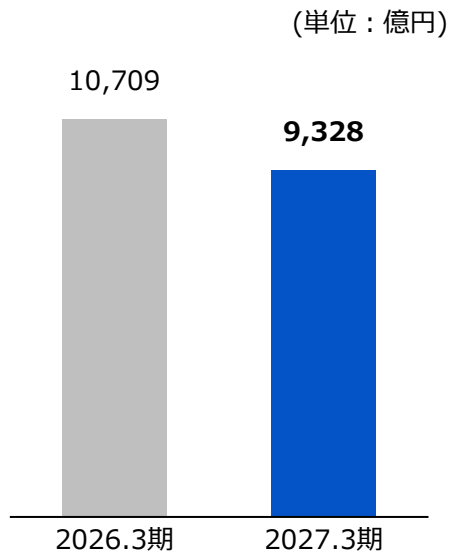
主に鹿児島霧島工場新棟におけるMLCC生産設備の導入等、成長領域への新規投資を主因に増加

(単位：億円)



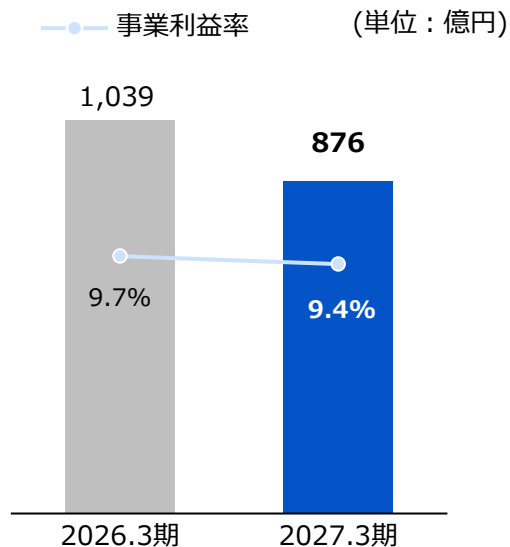
## 売上高

プリンティングデバイス事業の増収は見込まれるものの、サザンカールソン社譲渡等の特殊要因により減少



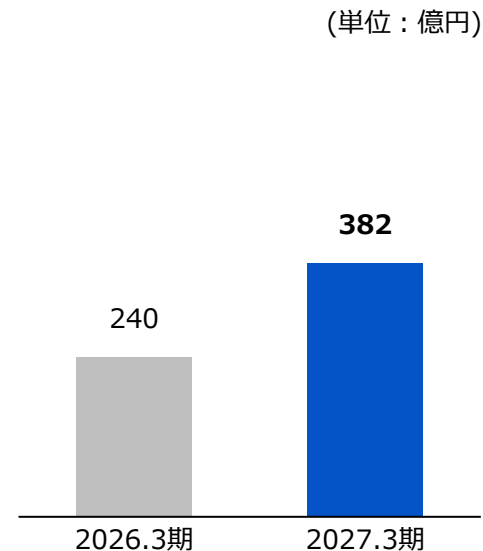
## 事業利益

各事業において収益改善は見込まれるものの、2026.3期に計上したサザンカールソン社譲渡に伴う利益の影響により減少



## 設備投資額

プリンティングデバイス事業の増産及びドキュメントソリューション事業の新製品製造に向けた投資を主因に増加

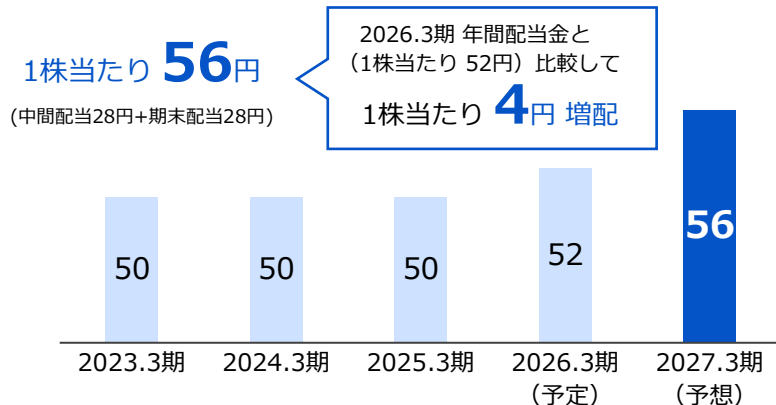


## 配当方針の変更 及び 2027.3期 配当予想

- 「株主資本\*に対する配当金の比率（DOE）」を配当指標に用いるとともに、1株当たり配当金を維持もしくは増額する「累進配当」を採用。
- 2027.3期及び2028.3期のDOEの水準：3.5%程度

\* DOEの基準となる「株主資本」は、「親会社の所有者に帰属する持分」から保有株式の時価や為替の影響による変動の大きい「その他の資本の構成要素」を除外した金額（調整後DOE）。

上記の新たな配当方針に基づき、以下の年間配当金を予想。



※全ての期において、2024年1月1日に実施した株式分割後の基準で算出しています。

## 自己株式の消却

2026.3期における総額2,000億円の自己株式取得により、発行済株式数に対する自己株式の保有比率が増加したため、適正な水準まで消却予定。



\*1 消却前の発行済株式数に対する自己株式の保有比率

\*2 消却後の発行済株式数に対する自己株式の保有比率  
(消却後の自己株式数は、2026年3月末現在の自己株式数を基準に算出)

## 自己株式の取得

資本政策の一環として、2027.3期においても自己株式の取得を実施予定。



東京証券取引所での売買高及び委託先金融機関の条件等を踏まえ、2027.3期中の市場買付けとして実施可能な最大規模の自己株取得を計画。

## 4. 2028.3期 経営計画

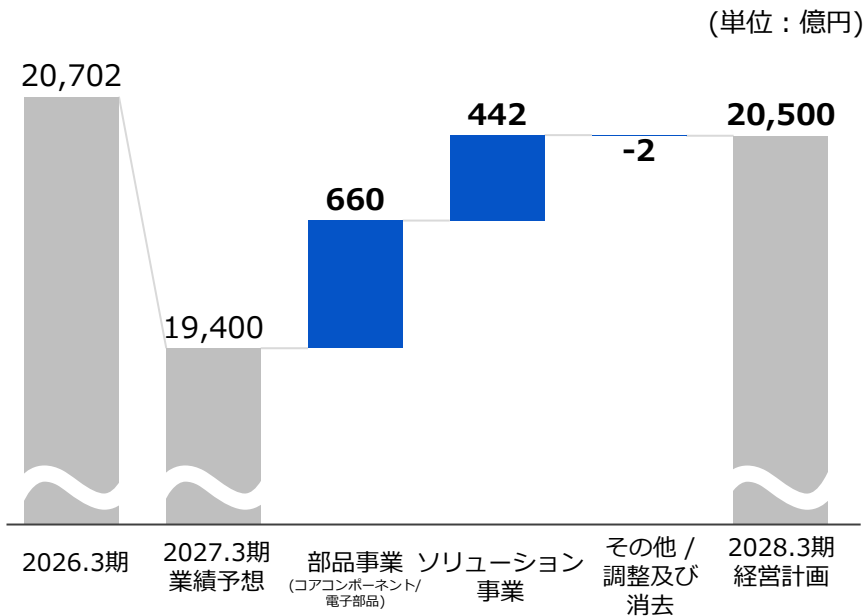
---

(単位：億円)

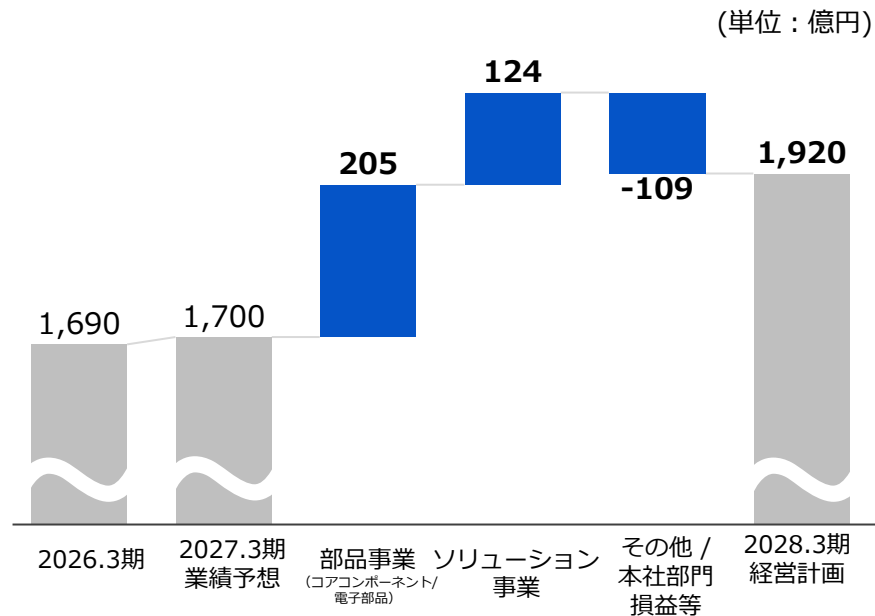
	2026.3期	2027.3期		2028.3期	
	金額 (売上高比)	金額 (売上高比)	2026.3期比	金額 (売上高比)	2027.3期比
売上高	20,702	<b>19,400</b>	-1,302	<b>20,500</b>	1,100
営業利益	1,181 (5.7%)	<b>1,300</b> (6.7%)	119	<b>1,600</b> (7.8%)	300
税引前利益	1,690 (8.2%)	<b>1,700</b> (8.8%)	10	<b>1,920</b> (9.4%)	220
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,410 (6.8%)	<b>1,410</b> (7.3%)	0	<b>1,500</b> (7.3%)	90
ROE(%)	4.3%	<b>4.3%</b>	0.0% <sub>pt</sub>	<b>5.0%</b>	0.7% <sub>pt</sub>
設備投資額	1,491 (7.2%)	<b>2,250</b> (11.6%)	759	<b>1,760</b> (8.6%)	-490
有形固定資産 減価償却費	1,109 (5.4%)	<b>1,200</b> (6.2%)	91	<b>1,300</b> (6.3%)	100
研究開発費	1,157 (5.6%)	<b>1,200</b> (6.2%)	43	<b>1,300</b> (6.3%)	100

## 2027.3期までに経営基盤の再構築の目途を付け、2028.3期より成長軌道へ回帰する見通し

### 売上高

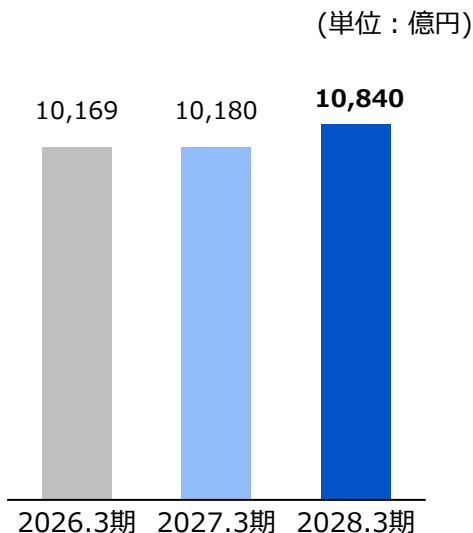


### 税引前利益



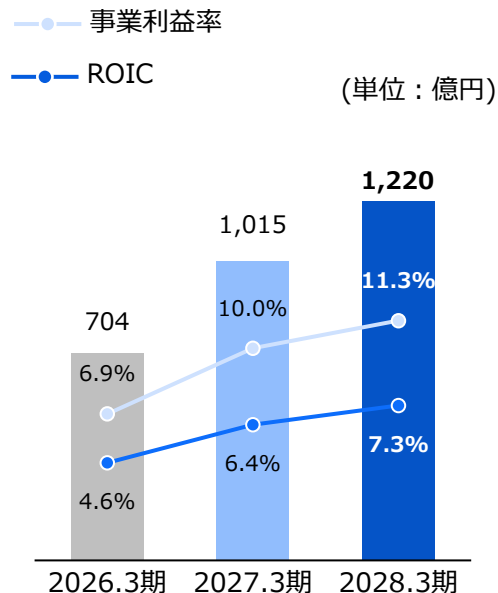
## 売上高

先端半導体・周辺領域等、  
重点領域での事業拡大により増収



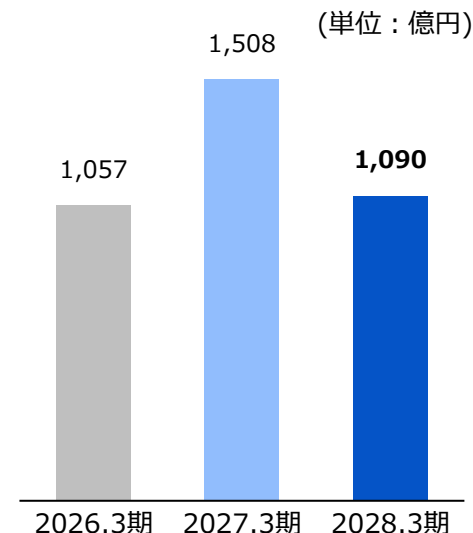
## 事業利益

半導体部品有機材料事業、及び電子  
部品事業の収益改善に加え、重点  
領域における高付加価値製品の販売  
増より増益



## 設備投資額

2027.3期には成長領域への新規投資  
を実施することから増加する一方、  
2028.3期には通常水準への減少を  
見込む



## 先端半導体・周辺領域の旺盛な需要を捉える当社独自の製品群

### 先端半導体製造装置用部品



#### ■市場動向

- ✓ 半導体の世代進化→微細化・高積層化
- ✓ 露光・現像・エッチング回数増加

対象装置の需要拡大・シェア拡大機会

#### ■商流と対象製品

### AIデータセンター用部品



#### ■市場動向

- ✓ AIサーバー普及拡大に伴う高速・大容量処理に向けた性能向上

光伝送化・スイッチ等周辺機器需要増

米国ビッグテック企業 (AIデータセンター向け)

欧米韓日 大手半導体製造装置メーカー

光トランシーバーメーカー

AI周辺機器メーカー

高シェア

高シェア

KYOCERA

露光機用ステージ

静電チャック

サファイヤ窓

ヒーター

検査装置用レンズ

ウェハハンド

KYOCERA

光送受信用セラミック基板

光通信用セラミックPKG

光スイッチ用セラミックPKG

KYOCERA

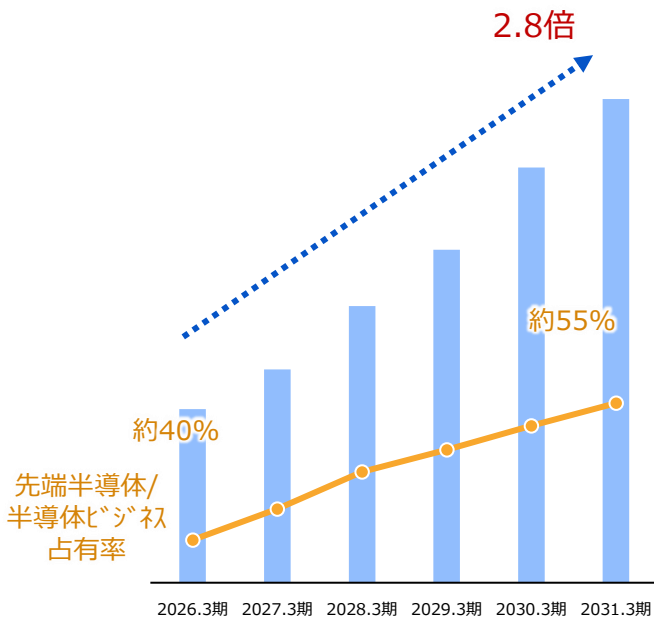
ネットワーク用有機PKG

大容量MLCC

タンタルコンデンサ

# 京セラのコア技術・顧客基盤を強みに先端半導体関連領域でのシェア拡大を目指す

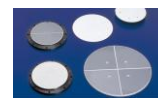
＜先端半導体・AI周辺領域ビジネス＞  
売上拡大計画



## 高シェア 主要アイテム・テクノロジー別の拡大戦略

### ■ SPE向けファインセラミック部品

- ✓ 高シェアセラミック構造部品の増産
- ✓ 露光・エッチング用への資源集中
- ✓ 次世代静電チャックへの参入によるシェア拡大



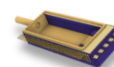
SPE用セラミック  
構造部品シェア



NEW

### ■ AI周辺ネットワーク用パッケージ

- ✓ 圧倒的シェア高速光通信用パッケージへの重点投資
- ✓ チップレットパッケージのセラミックコア基板の開発



光通信用セラミック  
パッケージシェア



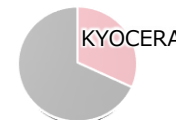
NEW

### ■ 高容量、高信頼性コンデンサ

- ✓ AIサーバー・データセンター向けMLCC及びポリマータンタルのシェア拡大



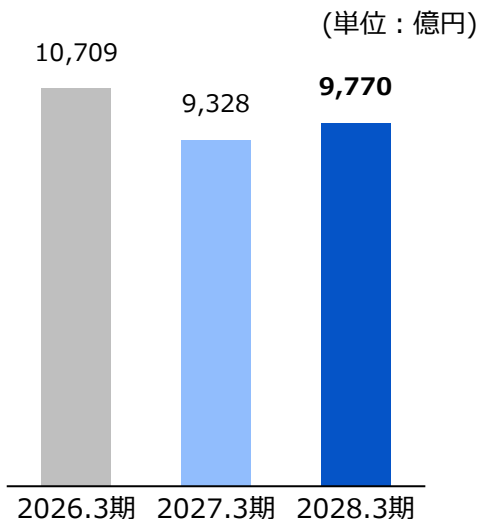
高容量小型  
コンデンサシェア



NEW

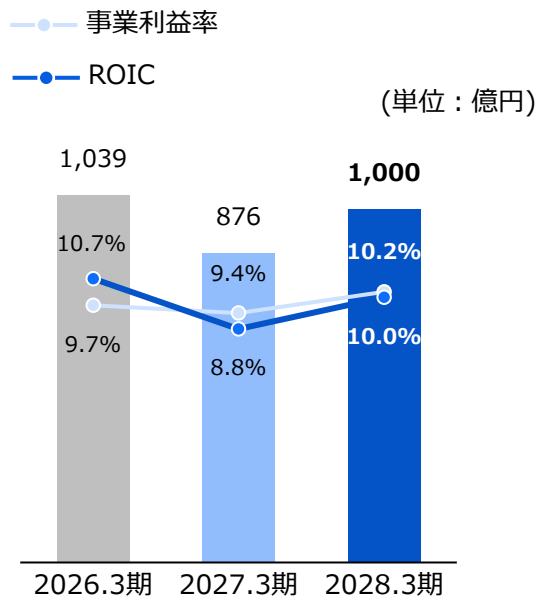
## 売上高

ドキュメントソリューション事業や  
コミュニケーション事業をはじめ  
各事業における高付加価値な新製品・  
新サービスの投入により増収



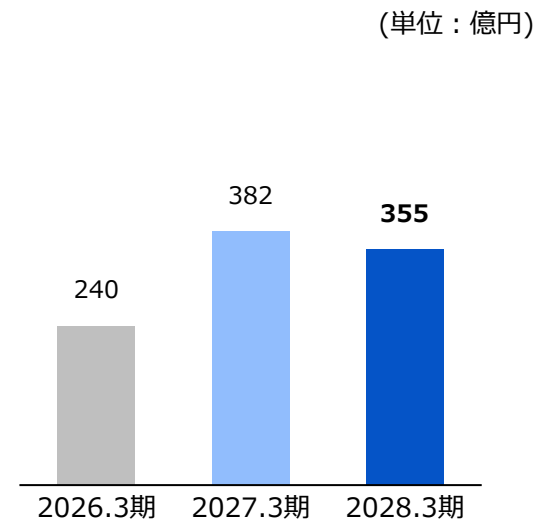
## 事業利益

増収効果に加え、各事業における原価  
低減及び生産性改善、不採算事業・  
拠点・商品の撤退・縮小により増益



## 設備投資額

2027.3期に引き続き、2028.3期に  
おいても積極投資を継続



**収益改善を更に進め ROIC 10% を実現、同時に次期成長の基盤づくり推進**

**高収益製品・サービスの拡大**

代表例

- ・高速複合機・商業用インクジェット機の新製品投入（情報機器）
- ・系統蓄電池エンジニアリング事業の強化（コミュニケーション）
- ・業界別 通信ソリューションの拡大（コミュニケーション）
- ・捺染用インクジェットヘッド需要増への対応
  - 設備投資による生産容量拡大（プリンティングデバイス事業）



**原価低減・生産性改善の推進**

代表例

- ・欧州組織の統合及びベトナム生産拡大による効果（情報機器、機械工具）
- ・部品の内製化（情報機器など）
- ・スマートファクトリー化の推進（情報機器、プリンティングデバイス事業など）

**不採算事業・拠点・商品の撤退・縮小**

- ・全てのプロダクトラインで継続実行

**「モノ×コト売り」の基盤作り** 人材育成、プロセス設計、プラットフォーム開発を推進

## 成長投資と株主還元の両立を図るとともに、企業価値向上を目的として株主資本を最適化

以下の内容は、本年2月3日に公表した内容を2027.3期の業績予想及び2028.3期の経営計画、並びに2026.3期末時点の保有株式の時価や為替レートを考慮して更新しています。

### 2027.3期及び2028.3期(2か年) キャピタルアロケーション 目標



### 2026.3期末 資本構成



### 2028.3期末 資本構成 目標



## 2026.3期～2028.3期

### 経営基盤の再構築

- ・ 2027.3期のROEはマクロ経済リスクを勘案し、2026.3期と同水準を計画
- ・ 2028.3期のROEは 5%の実現を図る

2026.3期実績  
ROE 4.3%

2027.3期予想  
ROE 4.3%

2028.3期目標  
ROE 5.0%  
以上

2025.3期実績  
ROE 0.7%

経営改革プロジェクト → 新経営体制にて改革を推進

## 2029.3期～2031.3期

### 事業成長の推進

2026年11月下旬  
事業戦略説明会 開催予定  
ROE目標達成に向けた  
経営計画を公表予定

2031.3期目標  
ROE 8.0%  
以上

将来目標  
ROE 10.0%  
以上

時価総額 5兆円超を目指す

インオーガニック成長

オーガニック成長 (AI関連製品、ソリューション事業の着実な拡大)

継続的な資本構成の最適化 (政策保有株式の縮減・株主還元の強化)

課題事業の収益改善 (有機パッケージ・KAVX)

## 5. 【ご参考】 補足資料

---

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
売上高 Sales Revenue	498,868	499,720	493,467	522,399	2,014,454	478,038	513,347	530,611	548,207	2,070,203
営業利益 Operating Profit	20,956	16,920	-25,601	15,024	27,299	18,550	23,395	28,676	47,517	118,138
税引前利益 Profit Before Income Taxes	47,765	4,055	-1,361	13,172	63,631	44,563	23,387	54,080	46,964	168,994
親会社の所有者に帰属する四半期利益 Profit Attributable to Owners of the Parent	36,797	-719	-17,747	5,766	24,097	37,143	18,397	42,411	43,018	140,969

円 / Yen

平均為替レート Average Exchange Rates	米ドル / US\$	156	149	152	153	153	145	147	154	157	151
	ユーロ / Euro	168	164	163	161	164	164	172	179	184	175

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
設備投資額 Capital Expenditures	31,914	37,019	32,815	40,184	141,932	59,015	29,725	33,913	26,446	149,099
有形固定資産 減価償却費 Depreciation Charge of PPE	28,844	28,310	28,694	26,229	112,077	26,871	27,719	28,277	28,057	110,924
研究開発費 R&D Expenses	29,529	28,403	29,265	28,890	116,087	27,705	29,473	29,193	29,330	115,701

# 事業セグメント別 売上高



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
<b>コアコンポーネント</b> <b>Core Components Business</b>	<b>145,088</b>	<b>149,147</b>	<b>148,004</b>	<b>149,481</b>	<b>591,720</b>	<b>145,856</b>	<b>161,802</b>	<b>169,512</b>	<b>176,259</b>	<b>653,429</b>
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	59,260	59,115	61,673	61,823	241,871	58,523	60,372	63,245	67,929	250,069
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	80,320	84,456	80,555	81,718	327,049	81,561	95,748	100,123	102,000	379,432
その他 Others	5,508	5,576	5,776	5,940	22,800	5,772	5,682	6,144	6,330	23,928
<b>電子部品</b> <b>Electronic Components Business</b>	<b>89,712</b>	<b>91,211</b>	<b>85,378</b>	<b>88,345</b>	<b>354,646</b>	<b>83,864</b>	<b>90,845</b>	<b>92,487</b>	<b>96,290</b>	<b>363,486</b>
<b>ソリューション</b> <b>Solutions Business</b>	<b>269,042</b>	<b>264,559</b>	<b>263,940</b>	<b>288,826</b>	<b>1,086,367</b>	<b>253,007</b>	<b>266,014</b>	<b>272,245</b>	<b>279,653</b>	<b>1,070,919</b>
機械工具 Industrial Tools Unit	85,865	74,945	70,986	74,080	305,876	80,038	76,945	74,304	54,649	285,936
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	115,037	117,185	119,839	127,903	479,964	107,415	113,505	121,735	135,824	478,479
コミュニケーション Communications Unit	51,318	54,162	53,347	66,670	225,497	45,586	53,229	54,149	66,194	219,158
その他 Others	16,822	18,267	19,768	20,173	75,030	19,968	22,335	22,057	22,986	87,346
その他の事業 Others	4,214	3,865	4,642	4,393	17,114	3,430	3,193	3,947	3,626	14,196
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-9,188	-9,062	-8,497	-8,646	-35,393	-8,119	-8,507	-7,580	-7,621	-31,827
<b>売上高</b> <b>Sales Revenue</b>	<b>498,868</b>	<b>499,720</b>	<b>493,467</b>	<b>522,399</b>	<b>2,014,454</b>	<b>478,038</b>	<b>513,347</b>	<b>530,611</b>	<b>548,207</b>	<b>2,070,203</b>

# 事業セグメント別 利益



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
<b>コアコンポーネント</b>										
<b>Core Components Business</b>	<b>12,917</b>	<b>4,130</b>	<b>-30,794</b>	<b>11,858</b>	<b>-1,889</b>	<b>14,188</b>	<b>15,832</b>	<b>20,324</b>	<b>12,738</b>	<b>63,082</b>
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	5,939	4,543	7,253	5,560	23,295	6,992	4,968	7,512	-742	18,730
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	6,704	-670	-38,366	5,885	-26,447	7,021	12,094	12,533	15,285	46,933
その他 Others	274	257	319	413	1,263	175	-1,230	279	-1,805	-2,581
<b>電子部品</b>	<b>1,055</b>	<b>-1,008</b>	<b>-1,458</b>	<b>593</b>	<b>-818</b>	<b>-3,008</b>	<b>3,025</b>	<b>1,920</b>	<b>5,379</b>	<b>7,316</b>
<b>Electronic Components Business</b>										
<b>ソリューション</b>	<b>19,569</b>	<b>13,977</b>	<b>18,077</b>	<b>22,073</b>	<b>73,696</b>	<b>18,879</b>	<b>18,883</b>	<b>20,235</b>	<b>45,946</b>	<b>103,943</b>
<b>Solutions Business</b>										
機械工具 Industrial Tools Unit	6,010	3,424	2,370	3,903	15,707	6,551	3,733	2,538	22,374	35,196
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	11,340	10,151	10,698	16,849	49,038	9,753	8,371	11,020	15,971	45,115
コミュニケーション Communications Unit	679	440	3,594	4,634	9,347	206	3,994	3,459	4,457	12,116
その他 Others	1,540	-38	1,415	-3,313	-396	2,369	2,785	3,218	3,144	11,516
その他の事業 Others	-11,388	-11,635	-12,142	-11,825	-46,990	-10,129	-11,523	-9,288	-10,228	-41,168
事業利益 計 Total Business Profit	22,153	5,464	-26,317	22,699	23,999	19,930	26,217	33,191	53,835	133,173
本社部門損益等 Corporate Gains and Others	25,612	-1,409	24,956	-9,527	39,632	24,633	-2,830	20,889	-6,871	35,821
<b>税引前利益</b> <b>Profit Before Income Taxes</b>	<b>47,765</b>	<b>4,055</b>	<b>-1,361</b>	<b>13,172</b>	<b>63,631</b>	<b>44,563</b>	<b>23,387</b>	<b>54,080</b>	<b>46,964</b>	<b>168,994</b>

# 事業セグメント別 受注高



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
<b>コアコンポーネント</b> <b>Core Components Business</b>	<b>153,201</b>	<b>148,276</b>	<b>143,355</b>	<b>142,584</b>	<b>587,416</b>	<b>149,408</b>	<b>158,161</b>	<b>164,251</b>	<b>169,103</b>	<b>640,923</b>
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	69,437	61,785	61,381	59,113	251,716	59,516	60,777	64,381	70,435	255,109
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	78,144	80,903	76,127	77,368	312,542	84,112	91,632	93,742	91,949	361,435
その他 Others	5,620	5,588	5,847	6,103	23,158	5,780	5,752	6,128	6,719	24,379
<b>電子部品</b> <b>Electronic Components Business</b>	<b>91,878</b>	<b>89,522</b>	<b>86,330</b>	<b>85,370</b>	<b>353,100</b>	<b>89,273</b>	<b>91,501</b>	<b>91,963</b>	<b>100,442</b>	<b>373,179</b>
<b>ソリューション</b> <b>Solutions Business</b>	<b>278,732</b>	<b>268,288</b>	<b>263,127</b>	<b>299,185</b>	<b>1,109,332</b>	<b>268,411</b>	<b>270,096</b>	<b>267,088</b>	<b>295,195</b>	<b>1,100,790</b>
機械工具 Industrial Tools Unit	86,338	74,937	71,307	74,804	307,386	80,602	77,461	76,170	56,900	291,133
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	114,824	117,507	118,036	127,134	477,501	107,807	113,431	121,647	135,741	478,626
コミュニケーション Communications Unit	57,080	54,933	52,418	77,782	242,213	60,357	57,278	47,914	79,102	244,651
その他 Others	20,490	20,911	21,366	19,465	82,232	19,645	21,926	21,357	23,452	86,380
その他の事業 Others	2,997	2,605	3,022	3,662	12,286	2,758	2,570	3,180	3,070	11,578
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-6,899	-7,743	-5,940	-11,758	-32,340	-6,684	-6,430	-5,197	-9,894	-28,205
<b>受注高</b> <b>Orders</b>	<b>519,909</b>	<b>500,948</b>	<b>489,894</b>	<b>519,043</b>	<b>2,029,794</b>	<b>503,166</b>	<b>515,898</b>	<b>521,285</b>	<b>557,916</b>	<b>2,098,265</b>

# 事業セグメント別 設備投資額



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	11,603	13,391	10,058	12,871	47,923	40,566	12,241	16,494	9,458	78,759
電子部品 Electronic Components Business	6,526	13,153	7,501	7,829	35,009	7,240	7,733	5,269	6,689	26,931
ソリューション Solutions Business	8,037	4,427	6,968	4,642	24,074	4,188	6,571	7,289	5,932	23,980
その他の事業 Others	1,092	883	1,316	12,411	15,702	2,405	1,460	3,417	1,733	9,015
本社部門 Corporate	4,656	5,165	6,972	2,431	19,224	4,616	1,720	1,444	2,634	10,414
合計 Total	31,914	37,019	32,815	40,184	141,932	59,015	29,725	33,913	26,446	149,099

# 事業セグメント別 有形固定資産減価償却費



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	11,899	12,040	12,386	10,018	46,343	10,186	10,699	10,781	10,838	42,504
電子部品 Electronic Components Business	7,971	7,612	7,305	7,167	30,055	7,568	7,619	7,783	7,711	30,681
ソリューション Solutions Business	6,157	5,942	6,186	6,065	24,350	6,121	6,303	6,548	6,285	25,257
その他の事業 Others	1,367	1,273	1,281	1,450	5,371	1,449	1,500	1,563	1,610	6,122
本社部門 Corporate	1,450	1,443	1,536	1,529	5,958	1,547	1,598	1,602	1,613	6,360
合計 Total	28,844	28,310	28,694	26,229	112,077	26,871	27,719	28,277	28,057	110,924

# 事業セグメント別 研究開発費



百万円/Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	5,546	5,327	5,669	4,862	21,404	6,470	6,597	6,383	6,670	26,120
電子部品 Electronic Components Business	4,132	3,556	3,338	2,962	13,988	3,097	4,423	4,116	4,252	15,888
ソリューション Solutions Business	10,076	9,621	9,169	12,162	41,028	9,212	9,100	9,383	9,804	37,499
その他の事業 Others	9,775	9,899	11,089	8,904	39,667	8,926	9,353	9,311	8,604	36,194
合計 Total	29,529	28,403	29,265	28,890	116,087	27,705	29,473	29,193	29,330	115,701

## 将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の一般的な状況
- (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
- (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
- (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
- (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
- (8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
- (9) 優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
- (11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
- (12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
- (13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
- (14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
- (15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
- (16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
- (17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
- (18) 売掛債権の信用リスク
- (19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
- (20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
- (21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。



京セラ株式会社